

---

**EMBASE TH AVEC SORTIES DROITES**  
*TH STRAIGHT HEADERS*

---

**1. BUT**

Cette spécification définit les caractéristiques générales ainsi que les performances électriques et mécaniques des embases pour le montage en surface au pas de 2,2 mm.

**1. SCOPE**

*This specification covers the conditions of use, mechanical and electrical performances of TH straight header with step 2.2mm.*

**2. PRESENTATION DU PRODUIT**

- Boîtier en PCT chargé 30% fibres de verre.
- Contacts en bronze pré-étamé.
- Fixation rapide carte imprimé 1.6mm ± 10%.

**2. PRODUCT PRESENTATION**

- *Housing reinforced 30 % glass fiber PCT.*
- *Contacts: Tin-plated bronze.*
- *Rapid fixing for PCB 1.6mm ± 10%.*

**3. DOCUMENTS DE REFERENCE**

Description	Références
Embase TH avec sortie droite 4 voies	x-1379700-x

**3. REFERENCE DOCUMENT**

Description	References
<i>TH straight headers housing 4 way</i>	<i>x-1379700-x</i>

**4. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT**

- Température : classe 2
  - Température d'environnement: -40 à +100°C
  - Température d'essai: 125°C
- Vibrations : classe 1
- Etanchéité : classe 0
- Tension nominale: 13.5 V
- Température maxi de refusions 260°C Suivant spec TE, TEC-109-201 Condition B

**4. CONDITIONS OF USE**

- *Temperature : class 2*
  - *Operating of temperature: - 40°C à +100°C*
  - *Test temperature: 125°C*
- *Vibration : Class 1*
- *Sealing : Class 0*
- *Nominal voltage : 13.5V*
- *Maximum reflow temperature 260°C according TE spec TEC109-201 condition B*

Rédigé par : D.Reifel/F.Vergne

Le 16-Octobre-2003

Approuvé par : J.J. REVIL

Le 23 Octobre 2003

Tyco Electronics France SAS  
B.P. 30039, 95301 CERGY-PONTOISE Cedex©2002 Tyco Electronics Corporation  
*All International Rights Reserved*  
(Tous droits réservés)

1 de 2

LOC F

Ce document est sujet à modifications. Contacter Tyco Electronics pour identifier la dernière révision et en obtenir une copie. Personnel Tyco Electronics : consultez la base de données StarTEC.  
This document, managed by Tyco Electronics France, is archived in the Startec database.  
A printout cannot be considered as a controlled document

5. EXIGENCE ET ESSAIS

5. REQUIREMENT AND TEST

EXAMEN GENERAL - GENERAL EXAMINATION			
Essais - Tests	Ref	Modalités - Modalities	Sanction - Requirements
Examen visuel. <i>Visual examination.</i>		Examen à l'œil nu <i>Naked eye examination</i>	Pas de défaut nuisant au bon fonctionnement. <i>No defect that would impair normal operation.</i>
ESSAIS ELECTRIQUES - ELECTRICAL TESTS			
Essais - Tests	Ref	Modalités - Modalities	Sanction - Requirements
Résistance d'isolement. <i>Insulation resistance.</i>	9.2	Tension d'essais:100 V pendant 1min, entre chaque contact. <i>Test Voltage: 100v during 1 min between one contact and the others.</i>	Ri ≥ 50 MΩ
Rigidité diélectrique. <i>Dielectric withstanding voltage.</i>	9.3	Tension d'essais : 1000V AC entre un contact et tous les autres réunis à la masse <i>Test voltage: 1000 V AC during 1 min between each contact.</i>	Ni claquage, ni amorce d'arc <i>No breakdown, no flashover</i>
ESSAIS MECANIKES - MECHANICAL TESTS			
Essais - Tests	Ref	Modalités - Modalities	Sanction - Requirements
Rétention des broches dans L'embase. Contact retention in the housing.	10.1.3	Appliquer sur chaque contact une force axiale de 25N. Applied an axial force of 25N.	Pas de deteriorations No damage
Détrempage circuit imprimé Pcb keying	10.1.5	Appliquer une force axiale de 50N sur une embase détrompée. Applied an axial force of 50N.	F ≥ 50N
Effort de montage de l'embase sur le circuit imprimé. Mounting header on the pcb		Appliquer une force axiale sur l'embase dans sa partie centrale. Applied an axial force on central housing.	F ≤ 50N
Rétention de l'embase non soudé sur le circuit imprimé. Retention header on the pcb		Appliquer une force axiale sur l'embase. Applied an axial force.	F ≥ 10N